

◆熱設計オンラインセミナー開催のお知らせ◆

『放熱材料・冷却デバイスの最新動向』

～車載機器からゲーム機、スマホ、基地局まで～

講師：国峯 尚樹 氏

(株)サーマルデザインラボ 代表取締役

日時：2021年2月5日（金）15：00～17：00

講師：国峯 尚樹 氏

(株)サーマルデザインラボ 代表取締役

演題：『放熱材料・冷却デバイスの最新動向』

～車載機器からゲーム機、スマホ、基地局まで～

主催：情報通信ネットワーク産業協会 装置実装委員会 実装技術 WG

参加：オンラインセミナー（一般公開・無料）

申込：受講希望者は1月29日までに下記ページよりお申し込み下さい。

<https://www.ciaj.or.jp/news/events/seminar>

オンラインセミナーのため、お申込みの方のメールアドレス宛に、当日のアクセス方法をご案内します。

<注意事項> ご提供いただきました個人情報は、CIAJ からの各種ご案内等に利用させていただきます。場合がございましたのであらかじめご了承下さい。

■講師紹介（敬称略）

国峯 尚樹（くにみね なおき）

1977年沖電気工業（株）入社

2007年（株）サーマルデザインラボ設立

主な著書

- ・熱設計完全制覇（日刊工業）
- ・熱設計完全入門（日刊工業）
- ・熱設計と数値シミュレーション（オーム社）
- ・トコトンやさしい熱設計の本（日刊工業）
- ・電子機器の熱流体解析入門第2版（日刊工業）
- ・トラブルをさけるための電子機器の熱対策設計第2版（日刊工業）

■講演概要

5G、IoT、CASE、AI、SiC等、様々なキーワードの下、機器の小型化・高性能化が進められています。車載機器やスマホ、基地局などファンレス密閉を要求される製品も多く、ギャップフィラーやPCM、ベーパーチャンバー、液体金属などの新しい材料、デバイスが活用されるようになってきました。こうした最新の冷却技術動向を紹介します。

【問い合わせ先】

CIAJ 共通技術部 宮守

E-mail: y-miyamori@ciaj.or.jp ※メールでの申込はできません

Tel: 03-5962-3452